

2020JEITA 部デ半第 1014 号
2021 年 1 月 12 日

各 位

(一社) 電子情報技術産業協会
集積回路&システムレベル技術委員会
半導体 EMC サブコミティ

Web セミナー開催のご案内

2020 年度 半導体 EMC セミナー (Web 開催)

～ EMC 規格の国際規格動向とプリント基板の EMC ～

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の諸事業に対しましては格別のご高配を賜わり、厚く御礼申し上げます。

JEITA 集積回路&システムレベル技術委員会・半導体 EMC サブコミティ (SC) では、半導体デバイスの EMC (Electromagnetic Compatibility : 電磁環境両立性) についてのご理解を一層深めていただくために、2015 年度に始まり毎年恒例となりました本セミナーを開催します。

2020 年度のセミナーは、コロナ禍の影響を鑑み、約 2 時間の短縮版とし、Web 会議形式で無料にて行います。まず当サブコミティの富島主査より『半導体 EMC の IEC 国際規格動向』について述べた後、株式会社 XrossVate の金子様より『プリント基板における SI/PI/EMC 対策 (仮)』と題して、DDR タイミング (2.4GHz~3.2GHz) や高速信号処理 (3.125GHz、5.6GHz) における EMC 設計について講演頂くと共に、この中で GHz 帯の EMC 基板設計のあり方についても考えていきます。これらの講演を通じて、皆様には国際規格を睨んだ上で、GHz 帯への EMC 設計や EMC 評価へのきっかけにしていただければと思います。

時節柄、業務ご多用のことと存じますが、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

敬 具

【開催概要】

日 時：2021年2月5日（金）15：00～17：30

場 所：Web-ExによるWeb会議形式での開催（予定）

※参加方法は、お申込みいただいた方のメールアドレスに、開催前日までにご案内いたします。

主 催：（一社）電子情報技術産業協会

集積回路&システムレベル技術委員会 半導体 EMC サブコミティ

定 員：100名（定員になりしだい締め切らせていただきます。）

テキスト：ダウンロードサイトより、電子データで提供いたします。

※ダウンロードサイトは、別途、ご案内いたします。

参加費： 無料

■参加申込方法

下記の URL より、必要事項をご記入いただき、参加申し込みをお願いいたします。

<申込サイト URL>

<https://39auto.biz/jeita-semicon/touroku/thread30.htm>

申込期限：2021年2月2日（火）

※ただし、申込期限までに定員に達した場合は、その時点で締切とさせていただきます。

■セミナーに関する問い合わせ

・事務局

（一社）電子情報技術産業協会

部品・デバイス部

担当：近藤

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-1-3 大手センタービル

TEL：03-5218-1061 FAX 03-52018-1080 E-mail：device3@jeita.or.jp

■個人情報保護について

※ご参加いただきました方の個人情報は、本セミナーの受付、JEITA 主催セミナーのご案内、セミナーアンケートでの質疑回答のために使用いたします。これら以外の目的で使用することはありません。

※JEITA の個人情報保護方針につきましては下記をご参照ください。

<http://www.jeita.or.jp/japanese/privacy/>

プログラム：

時間	内容	
15:00	開会の挨拶	JEITA/半導体 EMC-SC 広報 WG リーダ 長沼 健 [ルネサスエレクトロニクス株式会社]
15:10 ～ 15:45	半導体 EMC の IEC 国際規格動向	
	JEITA/半導体 EMC-SC 主査 富島 敦史 [東芝デバイス&ストレージ株式会社]	
	<p>JEITA 半導体 EMC サブコミティは、IEC SC47A へ日本の審議団体として参画し、集積回路に関する EMC 国際規格審議を行っております。</p> <p>本講演では、半導体 EMC 規格の全体像と最新トピックスを紹介し、EMC に対する要求が厳しくなる中で、半導体 EMC 国際規格の動向を解説します。</p>	
15:50 ～ 16:50	プリント基板における SI/PI/EMC 対策	
	株式会社 XrossVate エンジニアリング ディビジョン 金子 俊之 様	
	<p>LSI の高速化に伴い、LSI 設計、半導体 PKG 設計、プリント基板設計が連携して EMC 対策を行うことが重要になっています。そこで、各設計と連携した設計事例を御紹介するとともに、プリント基板で SI/PI/EMC 対策に効果的な材料や製造工法についてご紹介します。</p>	
16:55 ～ 17:10	質疑応答	
17:15	アンケート記入	
17:25	閉会の挨拶	JEITA/半導体 EMC-SC 副主査 林 靖二 [キヤノン株式会社]
17:30	終了	